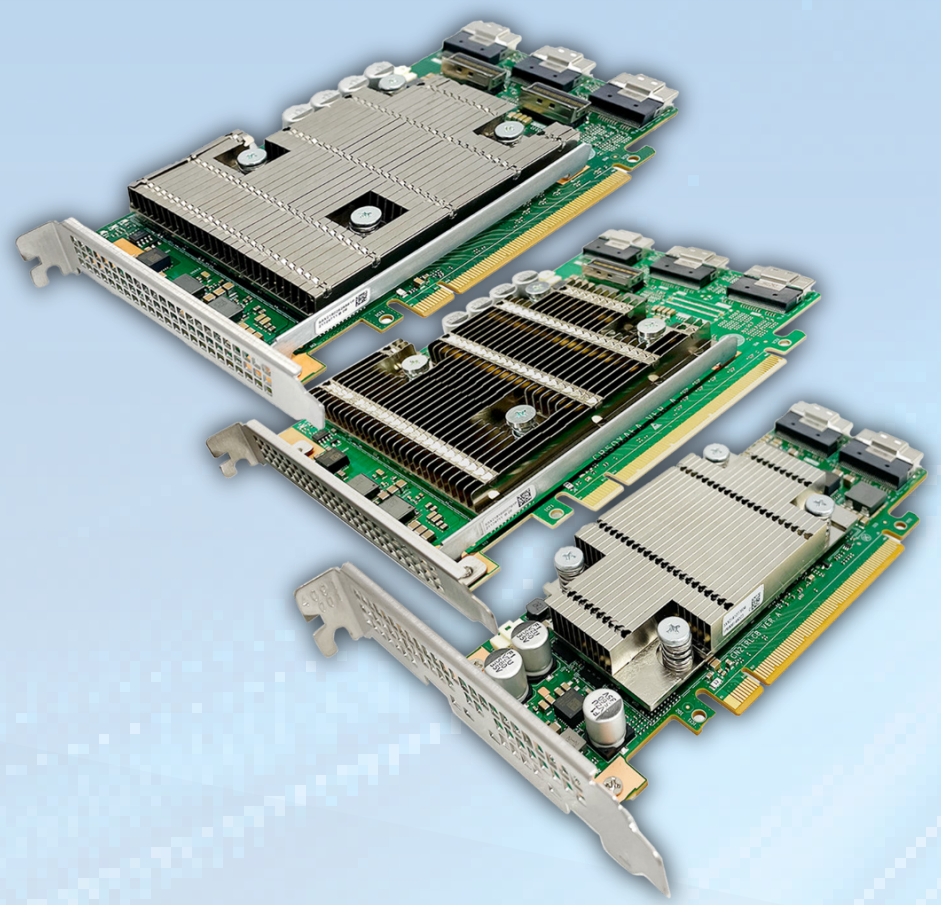
HUAWEI

构建万物互联的智能世界

SP686C 全自研RAID卡



高性能

硬盘直连:
最大支持40*SAS3.0硬盘直连

基础性能领先:
IOPS高于业界主流厂商20%

高可靠

固件在线升级:
支持双镜像实现固件在线升级，业务不中断

高集成

无需端口扩展板:
40口以下硬盘直挂，无需Expander

应用场景

运营商 | 分析应用程序 | 医学成像 | 媒体应用 | 企业数据库 | 云计算解决方案

SP686C技术参数

	SP686C-M-16i 2G	SP686C-M-16i 4G	SP686C-MH-32i 4G	SP686C-M-40i 2G	SP686C-M-40i 4G
上行主机接口	PCIe4.0 x 8		PCIe4.0 x 16	PCIe 4.0 x 8	
下行存储接口	12Gb/s SAS，6Gb/s SATA				
最大设备数（直连）	SAS/SATA: 16		SAS/SATA: 32	SAS/SATA：40	
连接器	2 x 8 SFF-8654Slimline		3 x 8 SFF-8654 Slimline + 1 x 8 LP Slimline	3 x 8 SFF-8654 Slimline+2 x 8 LP Slimline	
阵列级别	0，1，5，6，10，50，60，裸盘模式				
功能	支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 裸盘模式 读写高速缓存 初始化 重构 预拷贝 回拷 一致性校验 磁盘热备份		容量扩展 数据擦除 硬盘巡检 硬盘漫游 外部配置导入 掉电保护 写洞保护 SMART扫描 硬盘热插拔		
支持的操作系统	Linux				
尺寸（长高）	167.65mm x 111.15mm				
工作环境	运行环境0℃~55℃，5~95%无冷凝 非运行环境：-40 ℃~65℃，5~95%无冷凝				
工作电压	+12V，+3.3V				

如需了解华为SP686C 全自研RAID卡的更多信息，请联系华为销售代表或业务合作伙伴

© 华为技术有限公司 2024。
保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺

华为计算公众号